

Artikelnr.: UP-04-64-01-BUNDLE

## UP-Bundle mit Board (4 GB RAM/64 GB eMMC), Gehäuse und Netzteil

ab **319,31 EUR**

Artikelnr.: UP-04-64-01-BUNDLE

Versandgewicht: 0.52 kg

Hersteller: UP Bridge the Gap



### Produktbeschreibung

UP-Bundle mit Board (4 GB RAM/64 GB eMMC), Gehäuse, Netzteil Das UP Board mit x5-Z8350 CPU, 64 GB eMMC, 4 GB RAM, Gehäuse, Netzteil. UP entfesselt die Leistung der Intel x5-Z8350 quad-core 1.44 GHz (1.92 GHz) 64-bit 2 W SDP CPU. Der 40-polige I/O-Anschluss, USB 3.0 On-The-Go, Gigabit Ethernet, HDMI und vieles mehr machen das Board zu einer perfekten Lösung für verschiedenste Bereiche und Produkte wie Robotik, Drohnen, maschinelles Sehen, Heimautomation, digitale Beschilderung, intelligente Automobile oder das Internet Of Things. Die Kompatibilität mit Linux, Android und allen Windows 10-Versionen bietet Ihnen eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit und verkürzt außerdem die Markteinführungszeit. Das UP Board verfügt über eine x5-Z8350 CPU mit 64 GB eMMC & 4 GB RAM. Das UP-Bundle beinhaltet:

- UP Board
- Kühlkörper
- RTC-Batterie
- Kunststoffgehäuse
- Netzteil

- SoC: Intel(R) Atom(TM) x5 Z8350 64-bit-Prozessor - bis zu 1.92 GHz
- Grafik: Intel(R) HD 400 Graphics, 12 EU GEN 8, bis zu 500 MHz-Unterstützung DX\* 11.1/12, Open GL\* 4.2, Open CL\* 1.2 OGL ES3.0, H.264, HEVC (decode), VP8
- Systemspeicher: 4 GB DDR3L
- Speicherkapazität: 64 GB eMMC
- Externe USB 2.0-Anschlüsse: 4x
- USB 2.0-Ports (pin header): 2x
- USB 3.0-Port: 1x (OTG)
- Ethernet: 1x GB Ethernet (full speed) RJ-45
- Video-Ausgang: HDMI
- Display-Schnittstelle: DSI / eDP
- Kameraschnittstelle: MIPI-CSI
- Eingangsleistung: 5 V DC-in (at) 3 A, 5.5 / 2.1 mm Jack
- RTC: Ja
- PXE: Nein
- WOL: Ja
- Feuchtigkeit: 10 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Betriebstemperatur: 32 °F - 140 °F / 0°C ~ 60 °C
- Erweiterung: 40-poliger Allzweck-Bus, unterstützt durch Altera Max V. ADC 8-bit (at) 188ksos
- Kompatible Betriebssysteme: Microsoft Windows 10 Komplettversion, Windows IoT Core Linux (ubinux, Ubuntu, Yocto); Android Lollipop; Brillo
- Zertifizierungen: CE/FCC Class A, RoHS-konform, Microsoft Azure-zertifiziert
- Maße: 3.37" x 2.22" / 85.60 mm x 56.5 mm
- Gewicht: 88 Gramm
- CEC: Nein

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten



